

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 2025 年持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
保荐代表人姓名：秦瀚东	联系方式：0755-83237439 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
保荐代表人姓名：沈杰	联系方式：0755-88999729 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕425号文”批准，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（简称“公司”或“唯捷创芯”）公开发行股票 4,008 万股，占发行后总股本的 10.02%。本次公司发行新股的发行价为 66.60 元/股，募集资金总额为 266,932.80 万元，扣除发行费用 16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。本次公开发行股票于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本持续督导年度报告书。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务。	保荐机构已与唯捷创芯签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解唯捷创芯经营情况，对唯捷创芯开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于	2025 年度，唯捷创芯在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明

序号	工作内容	持续督导情况
	披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2025 年度，唯捷创芯在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导唯捷创芯及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促唯捷创芯依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对唯捷创芯建立健全并有效执行内控制度履行了督导职责，唯捷创芯的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促唯捷创芯严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对唯捷创芯的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，不存在由于公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充而应向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	截至 2025 年末，唯捷创芯不存在控股股东与实际控制人；2025 年度，唯捷创芯及其原实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项。

序号	工作内容	持续督导情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	截至 2025 年末，唯捷创芯不存在控股股东与实际控制人；2025 年度，唯捷创芯及其原实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2025 年度，保荐机构持续关注公共媒体关于唯捷创芯的报道及相关市场传闻，经保荐机构核查，唯捷创芯不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2025 年度，唯捷创芯未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2025 年度，唯捷创芯不存在需要专项现场检查的情形。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2025 年度，唯捷创芯不存在未履行承诺的情况。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

## **（一）核心竞争力风险**

### **1、研发失败的风险**

公司新产品的研发风险主要来自以下几个方面：（1）新产品研发周期长，可能耗时半年至数年，在产品规划阶段，若公司产品定位错误，可能导致研发的新产品不适应未来市场需求的发展变化；（2）若公司对自身技术开发能力和产品开发的成功率判断失误，可能导致产品开发过程无法顺利推进，或者研发设计的产品不能成功流片、未达到预定性能等；（3）新产品上市销售阶段，若产品方案不够成熟，市场接受程度不理想，可能导致新产品销售迟滞，无法有效的收回前期研发投入的成本，影响公司的经营业绩以及后续研发工作开展。

### **2、产品升级迭代的风险**

射频前端芯片产品部分应用于消费电子行业，该行业具有产品迭代频繁、市场格局变动较快等特点。此外，公司产品也需要随着不断发展的通信技术进行迭代。公司需及时推出满足市场需求的新产品并保持前瞻性，以保持市场竞争力。如果公司的技术升级速度和产品迭代成果未达到预期水平，未能及时、有效满足市场需求，或出现颠覆性、革新性的新技术导致公司现有产品被替代，则存在公司产品升级迭代的风险，导致公司的行业地位和市场竞争力下降。

### **3、优秀研发人才流失的风险**

公司专注于集成电路的设计环节。对于射频前端芯片，研发人员应具备扎实的设计理论知识，基于对材料和封装工艺的深入了解，通过复杂的电路设计实现各类性能指标的优化和均衡，完成既定研发目标。但集成电路行业整体面临较大的专业人才缺口，如果发生优秀研发人才大面积流失的情况，将对公司的研发实力、生产经营和市场竞争力产生不利影响。

### **4、技术秘密泄露的风险**

公司的各类核心技术贯穿于公司产品的研发设计、工艺选型、封装、测试等各个环节，是公司长时间投入各种资源积累的成果，也是公司保持产品市场竞争力的基础和保障。技术秘密的保密工作对公司维持产品及技术的竞争力尤为重要。对于未公开的非专利技术及体现研发战略的在研产品，若保密不当导致泄露，则

可能严重削弱公司技术的优势和产品的竞争力。

## **（二）经营风险**

### **1、营业收入无法持续高速增长，盈利水平同时受到影响的风险**

公司产品主要应用于智能手机之中，智能手机行业具有竞争激烈、产品和技术更迭较快、头部品牌厂商集中且市场占有率较高的特点。公司客户或终端客户主要为知名品牌厂商，若出现智能手机行业整体出货量下降、公司与头部品牌厂商的合作关系发生变化、头部品牌厂商采用自研射频前端芯片、现有主要客户的终端市场占有率大幅下降等不利因素，或公司未能及时拓宽及迭代产品线、开拓新的应用领域以应对激烈的市场竞争，均可能导致下游行业及客户对公司产品的采购需求降低。

### **2、毛利率相对较低的风险**

公司主要产品为射频功率放大器模组，通过和境外可比上市公司进行比较，公司毛利率相对较低。公司产品销售单价受美系和日系领先厂商同类产品的市场定价、产品及技术的先进性、客户议价能力以及过往销售价格等因素的共同影响；产品单位成本亦受原材料及封测服务的采购单价以及产业链供需关系等因素影响，存在一定的不确定性。若公司未能及时推出更先进的产品争取更高的利润空间、产品的竞争力不足、无法适应市场竞争导致销售价格持续下降，或未来原材料或封装测试服务产能供给紧张导致采购价格上涨，或公司在供应链中的议价能力下降，均可能导致公司无法进一步改善毛利率，对盈利能力产生不利影响。

### **3、客户集中度较高的风险**

公司主要采用经销或直销模式向手机品牌或 ODM 厂商销售产品，下游终端市场以及产业链特点决定了客户的集中度较高。报告期内，公司对前五大客户的营业收入合计数占收入的比例为 91.96%。公司的经营业绩与头部手机品牌厂商的经营情况相关性较高，如未来该等头部手机品牌厂商的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与头部手机品牌厂商的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

### **4、优质供应商替代性选择较少的风险**

报告期内，公司向主要供应商的采购集中度较高且晶圆供应商主要为境外供应商。全球半导体产业链中，与上述原材料和封装测试服务供应商在产品质量、技术实力和供应能力方面相同或接近的替代性选择较少。若公司因供应商或公司自身业务发展考虑、集成电路产业链产能紧张、全球贸易环境的不利变化等因素而主动或被动与上述一个或多个供应商中断或终止合作，亦或其大幅提升供货价格、结算要求等，且公司难以及时转向其他合格的替代供应商，公司可能面临产品性能或质量表现下降、产能不足、原材料供应短缺从而影响经营业绩的风险。

### **（三）财务风险**

#### **1、应收账款回收风险**

截至 2025 年末，公司应收账款账面价值为 38,540.91 万元，占流动资产的比例为 9.76%。然而，随着公司经营规模的持续扩大，受市场环境和客户经营情况变动等因素影响，公司应收账款余额可能逐步增加。若未来公司应收账款不能及时回收，将对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

#### **2、汇率波动的风险**

2025 年内，公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况。随着业务规模持续扩大，若国内外政治、经济环境发生变化，汇率变动将存在较大不确定性。未来，若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

#### **3、政府补助减少和政策变化风险**

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 1,923.10 万元。如果未来公司享受的政府补助政策取消，或政府补助政策、补助力度等发生不利调整，将对公司经营业绩和盈利产生不利影响。

#### **4、存货跌价风险**

公司存货主要由原材料、半成品以及库存商品构成。报告期末，公司存货账面价值为 48,955.50 万元，占流动资产的比例为 12.40%。若市场需求环境发生变化，市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道，优化库存管理，将可能导致公司产品滞销、存货积压，存货跌价风险提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。

## （四）行业风险

### 1、市场竞争加剧的风险

目前，全球射频前端市场主要由 Broadcom、Skyworks、Qorvo、Qualcomm 和 Murata 等美日厂商主导，且占据了我国射频前端芯片行业的高端产品市场，对国内试图进入中高端产品市场的企业造成极大的竞争压力。面对该等头部厂商的竞争压力，对于性能相似的产品，公司可能采取为客户提供更佳性价比的策略获取订单，存在因此导致产品利润水平和现金流承压的风险。此外，近年来国内企业仍在中低端领域充分竞争，以“价格战”为主要竞争策略的市场环境下，若公司不能进一步向中高端市场实现更大的突破，存在面临国内同业企业竞争加剧，导致公司盈利能力下降的风险。

### 2、行业政策波动风险

集成电路行业作为我国的重点扶持产业，长期以来受益于国家政策的支持和推动。若未来国家针对集成电路设计行业的产业政策发生调整或变化，集成电路设计行业增长势头可能因此受到不利影响，导致公司面临一定的行业政策波动风险，在市场竞争中面临不确定性和压力。

### 3、供应商产品和服务质量的风险

公司自设立以来以 Fabless 模式开展经营，将芯片各类原材料的制造、加工、封装、测试等环节委托外部供应商完成，这对公司的供应链管理能力和产品质量提出了较高要求。而射频功率放大器模组是耗能高、功率大的器件，在应用过程中若出现质量问题，将导致通讯设备丧失部分通讯功能。

若出现某一供应商原材料性能、质量不达标等问题，将直接影响公司最终芯片产品的可靠性、稳定性和性能表现，可能导致终端客户产品的消费者体验不佳，损害客户品牌商誉，进而严重影响客户关系和经营业绩。

## （五）宏观环境风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级。鉴于集成电路产业系全球产业链高度分工化合作的行业，产业链在国际贸易摩擦中均不可避免受到一定程度的负面影响。

作为集成电路设计企业，公司及公司现有供应商大部分都不同程度地使用了国外的设备或技术，若贸易摩擦进一步加剧，公司的研发设计以及产品供应都可能受到影响。

## **（六）其他重大风险**

### **1、知识产权风险**

公司自设立以来，通过自主创新申请并积累了多项知识产权。然而，公司不能排除竞争对手或其他第三方利用无效专利和公知技术主张公司或上下游供应商、客户侵犯其知识产权的可能性，存在竞争对手采用恶意诉讼或其他手段发起知识产权争议或纠纷，试图直接或间接影响公司声誉、阻碍公司经营发展的风险。此外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 58 项境外注册的专利，由于不同国家、不同法律体系对知识产权的权利范围的解释与认定存在一定差异，可能存在由此引发知识产权争议和诉讼的风险。

### **2、技术授权风险**

公司技术和产品研发的过程中需要使用电子设计自动化软件（EDA），并取得相关 EDA 供应商的技术授权。鉴于 EDA 市场目前形成的寡头竞争格局，主要国外厂商的 EDA 工具在其细分功能领域没有可靠的替代性产品。如果 EDA 供应商取消对公司技术授权，将导致研发和生产工作无法正常开展，对公司业务和经营产生重大不利影响。

### **3、产品质量纠纷风险**

大型品牌客户对射频功率放大器可靠性要求非常严苛。然而，导致射频功率放大器出现故障的可能因素较多，除产品自身设计、原材料质量、晶圆制造和封测质量等因素外，若其他配合使用的器件存在质量或设计问题，也可能导致射频功率放大器模组工作出现故障。基于上述，排查并确定故障原因的难度高、耗时长，公司、客户和供应商可能对产品质量责任的判断存在不一致的理解或纠纷，给公司带来法律、声誉及经济等方面不利影响。

### **4、内控体系建设及内控制度执行的风险**

公司已根据现代企业管理的要求，逐步建立健全了符合科创板上市公司要求的内部控制体系，但上述制度及体系的实施时间较短，且仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善。若公司因内控体系不能及时完善，或有关内部控制制度不能有效实施，将直接影响公司生产经营活动的合规性以及运作效率，进而影响公司经营管理目标的实现。

#### 四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,320,962,267.77	2,103,040,242.61	10.36
利润总额	18,114,716.26	-29,098,271.84	不适用
归属于上市公司股东的净利润	43,632,306.42	-23,725,130.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,882,963.23	-52,672,138.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	774,396,082.66	-318,255,041.03	不适用
主要会计数据	2025年末	2024年末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,023,430,407.95	3,992,010,080.34	0.79
总资产	4,729,380,580.14	4,589,971,914.29	3.04

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.10	-0.06	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.09	-0.59	增加 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.60	-1.30	增加 1.90 个百分点

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增 减 (%)
研发投入占营业收入的比 例 (%)	17.94	20.83	减少 2.89 个百分点

2025 年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、2025 年度，公司实现营业收入 232,096.23 万元，较上年同期增长 10.36%；归属于上市公司股东的净利润 4,363.23 万元，较上年同期增加 6,735.74 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,388.30 万元，较上年同期增加 7,655.51 万元。业绩增长主要系：①高集成度模组驱动销量增长，车规与 AI 端侧新兴领域需求释放：高集成度模组销量显著提升，产品技术优势获得市场认可；车规级产品的长尾效应逐步显现，往期订单持续交付与新增订单形成叠加效应，推动销量稳步攀升；Wi-Fi 模组销量快速增长，成为业绩增长的重要引擎。②应用场景多元化开拓新增长点，新兴领域需求爆发：公司积极布局 AI 端侧设备、智能机器人及车载通信等新兴领域，产品成功切入高成长性赛道。③产品结构优化提升盈利质量，高毛利产品占比攀升：车规级产品、Wi-Fi 模组等新品的收入占比大幅提升，其高附加值特性有效拉动了整体盈利水平，叠加供应链成本管控能力的增强，实现了量利齐升的良性发展。

2、2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 77,439.61 万元，较上年同期增加 109,265.11 万元，主要系销售需求的增长直接拉动了原材料的采购规模，从而使得公司的经营性应付项目随之增加。同时公司库存得以消耗，两者共同导致经营活动的现金流量净额同比转负为正。

3、2025 年度，公司股份支付费用 2,339.43 万元。剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 6,702.66 万元、4,727.73 万元。

4、2025 年度，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均实现转负为正，加权平均净资产收益率同比增加 1.68 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加 1.90 个百分点，主要系报告期内净利润同比扭亏为盈，大幅增长所致。

5、2025 年度，公司研发投入占营业收入的比例为 17.94%，较上年同期减少 2.89 个百分点，主要系报告期内营业收入规模增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）核心竞争力分析

自创立以来，公司始终以创新的设计和卓越的技术实力，深耕射频前端芯片领域，致力于成为全球领先的射频解决方案提供商。面对 5G-Advanced 商用、AI 终端爆发及智能网联汽车普及的行业变局，公司凭借深厚的技术积淀、卓越的产品矩阵及敏捷的市场响应机制，构建了难以复制的核心竞争壁垒。

#### 1.技术引领与先发优势：构筑高集成度与新兴赛道的护城河

**战略前瞻与高强度投入：**公司将技术创新视为发展的核心驱动力。2025 年，公司启动新一代研发中心建设，重点聚焦高集成度模组（L-PAMiD/L-PAMiF）、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8 及卫星通信等前沿方向，确保技术储备领先行业。公司紧密跟踪通信技术演进路径，从 5G 向 5.5G 及 6G 预研延伸，通过融合先进工艺与创新技术，持续推动产品性能跃升，确保在技术变革浪潮中始终占据主动。

**研发团队与成果：**公司拥有一支由行业资深专家领衔的高素质研发团队。截至报告期末，研发人员总数达 313 人，占员工总数的 52.87%，核心成员均拥有十余年射频器件及模组设计经验。公司实施极具竞争力的股权激励与人才引进计划，构建了稳固的人才梯队。报告期内，公司及子公司新增授权国内发明专利 14 项，累计拥有国内发明专利 93 项、实用新型专利 92 项、集成电路布图设计登记 143 项。这些自主知识产权不仅彰显了公司的原始创新能力，更为高集成度模组的国产化替代奠定了坚实的法律与技术基础。

#### **关键技术突破与量产领跑：**

**高集成度模组（L-PAMiD）：**公司是国内率先实现 L-PAMiD 模组大规模量产的厂商之一。2025 年，第二代 Phase 7LE Plus 模组凭借卓越的效率与功耗表现，已成功进入主流品牌旗舰机型供应链并实现大批量出货，标志着公司在高端市场正式打破国际垄断。同时，面向中高端市场的 Phase 8L 模组也已全面批量交付，确立了公司在下一代高集成度方案中的先发优势。

**AI 与泛连接技术:** 公司敏锐捕捉 AI 终端市场机遇, 率先推出适配 AI 眼镜、机器人等端侧设备的大功率 Wi-Fi 7 模组及 Wi-Fi/蓝牙双模模组, 相关产品已随客户终端正式上市, 成为 AI 硬件爆发的核心受益者。

**车规与卫星通信:** 公司不仅是国内首批通过 AEC-Q100 车规级认证的射频企业, 更在 2025 年联合模组厂商成功推出车载卫星通信模组, 实现了从地面蜂窝到天地一体化的技术跨越, 提前卡位智能网联汽车的高阶通信需求。

## **2.产品矩阵与一站式交付: 全场景覆盖与自主测试闭环**

**全品类一站式解决方案:** 公司已构建起业界领先的“全频段、全制式、全场景”产品矩阵, 涵盖 TxM、MMMB PA、L-PAMiD、L-PAMiF、L-FEM、LNA Bank、DiFEM、卫星通信、Wi-Fi 6/7 及蓝牙模组等全系列产品。无论是智能手机、平板、穿戴设备, 还是汽车电子、无人机、AI/AR 眼镜及工业机器人, 公司均能提供从分立器件到高集成度模组的定制化解决方案。这种“一站式”服务能力有效降低了客户的供应链管理成本与风险, 缩短了产品上市周期, 显著增强了客户粘性。

**产品结构高端化转型:** 公司成功实现了从中集成度向高集成度模组的战略转型。公司凭借 Phase 8L 等新一代产品的性价比优势, 加速了 5G 分立方案向模组化方案的渗透, 既巩固了高性价比市场的占有率, 又在高端市场开辟了新的增长极, 实现了“量价齐升”的良性循环。

**自主可控的测试验证体系:** 公司建立了行业领先的自有测试实验室及工厂, 具备了全流程自主验证能力。自主研发的自动化测试工具与方案, 不仅大幅提升了测试精度与效率, 更在外部产能紧张时保障了高集成度模组的快速交付。这种“设计-测试-验证”的端到端闭环能力, 确保了产品在高复杂度应用场景下的极致可靠性, 成为公司应对市场波动、快速响应客户需求的关键底气。

## **3.敏捷响应与生态协同: 深度绑定与供应链管控**

**客户需求导向:** 公司推行“研发-市场-服务”一体化协同机制, 将客户需求直接嵌入产品研发源头, 实现市场与研发的高效协同。通过与主芯片厂商的联合定义, 公司能够在新平台发布初期即完成射频模组的适配与认证, 实现“芯片发布, 模组同步上市”。这种深度协同模式, 使公司能够精准把握市场窗口期, 以

最快的速度响应品牌客户对旗舰机型的定制化需求。

内部管理与外部协同：公司严格执行高于行业标准的质量管理体系，完美匹配一线品牌客户的严苛要求。在供应链端，公司与全球顶级晶圆厂、封测厂建立了长期战略合作伙伴关系，并通过多元化供应商策略与核心设备自购计划，有效平抑了产能波动风险。依托规模化采购优势，公司具备强大的成本控制与议价能力，确保了在复杂地缘政治环境下的供应链安全与交付稳定性。

前瞻布局与趋势预判：公司始终紧密关注下游客户和终端消费者的需求，积极预判未来技术趋势并提前战略布局。

(1) Wi-Fi 7：提前布局并率先量产，抢占高速无线连接市场；

(2) 智能汽车：早期参与车规标准制定（如牵头制定车用射频前端团体标准），成为车企首选的国产射频厂商；

(3) AI 终端：前瞻性开发大功率 Wi-Fi 模组和蓝牙模组，精准对接 AI 端侧产品需求。

## （二）核心竞争力变化情况

2025 年度，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司进行持续性的研发投入。2025 年度，公司研发投入具体情况如下：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	变化幅度 (%)
费用化研发投入	416,339,822.03	437,973,995.19	-4.94
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	416,339,822.03	437,973,995.19	-4.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	17.94	20.83	减少 2.89 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2025 年度，公司主要在研项目进展顺利，取得一定的研发成果。2025 年度，

公司新获授权专利 44 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 30 项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得专利 187 项（其中发明专利 93 项），集成电路布图设计专用权 143 项。研发成果具体情况如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	41	14	252	93
实用新型专利	25	30	122	92
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	0	0	18	17
其他	0	22	167	143
合计	66	66	561	347

注 1：“其他”代指集成电路布图设计。

注 2：上表数据不包含已失效情形。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	266,932.80
其中：超募资金金额	1,529.31
减：直接支付发行费用	16,681.67
二、募集资金净额	250,251.13
减：	
以前年度已使用金额	196,492.98
本年度使用金额	28,769.18
暂时补流金额	-
现金管理金额	123,699.95
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-研发中心项目结项结余资金	400.23
加：	
募集资金利息收入	160.24
其他-2025 年 12 月 31 日度现金管理类产品投资收益和现金管理类产品到期赎回	106,810.25
三、报告期期末募集资金余额	7,859.29

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

唯捷创芯无控股股东及实际控制人。截至2025年12月31日，唯捷创芯董事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名/名称	类别	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股比例（%）
荣秀丽	董事长	53,265,280	6,556	53,271,836	12.38
孙亦军	董事、总经理	14,599,592	7,040,548	21,640,140	5.03
辛静	董事、财务负责人	1,058,766	5,217,574	6,276,340	1.46
周颖	董事	1,475,194	5,283,144	6,758,338	1.57
钟英俊	董事	-	-	-	-
许家硕	董事	-	-	-	-
蔡秉宪	董事	-	-	-	-
罗毅	独立董事（离任）	-	-	-	-
杨丹	独立董事	-	-	-	-
张恕恕	独立董事	-	-	-	-
黄吉	独立董事	-	-	-	-
王成	独立董事	-	-	-	-
赵焰萍	董事会秘书	1,008,362	4,134,578	5,142,940	1.20

公司部分董事、高级管理人员通过中信建投唯捷创芯1号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“唯捷创芯1号资管计划”）间接持有公司股份。前述资管计划持有公司股份的限售期为12个月，限售期自公司在上海证券交易所科创板上市之日起开始计算。

2025年度，唯捷创芯1号资管计划减持63,907股，截至2025年12月31日，唯捷创芯1号资管计划持有公司424,458股股份，公司部分董事及高级管理人员持有资管计划份额情况如下：

姓名	职务	参与资管计划名称	持有资管计划份额比例	持有份额报告期内是否发生变化
孙亦军	董事、总经理	唯捷创芯1号资管计划	3.45%	否
辛静	董事、财务负责人	唯捷创芯1号资管计划	3.45%	否
周颖	董事	唯捷创芯1号资管计划	3.45%	否
赵焰萍	董事会秘书	唯捷创芯1号资管计划	-	否

除上述情况外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事和高级管理人员持有公司的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

#### 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导年度报告书出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 秦瀚东  
秦瀚东

沈杰  
沈杰

